

PSA

PASSIVE SYSTEM ALLIANCE

HannStar Board Corporation

Copyright © by Passive System Alliance | All rights reserved.

PASSIVE SYSTEM ALLIANCE

瀚宇博德(5469)

2019年法人說明會

2019/5/15

Copyright © by Passive System Alliance | All rights reserved.

2

PSA
HannStar Board Corporation

免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際表現、財務狀況或營運結果將可能明顯不同於該對未來展望的表述內容。

除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前瀚宇博德股份有限公司之財務狀況或營運結果。

簡報內容

□ 財務報告.....P05

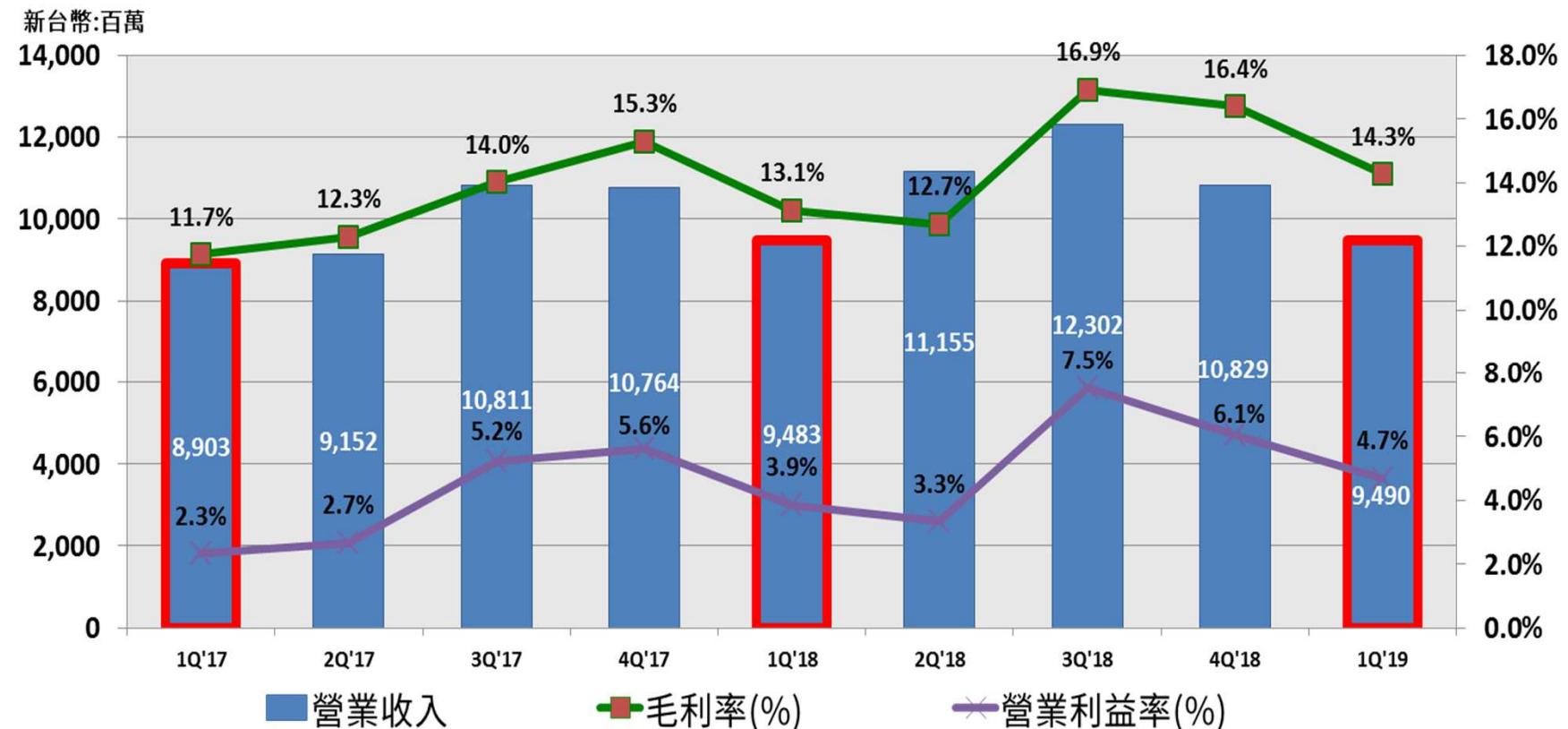
□ 營運與展望.....P12

財務報告

合併損益比較(YoY)

新台幣：百萬	2017	2018	年成長(%)	1Q'19
營業收入	39,629	43,769	10%	9,490
營業毛利	5,335	6,521	22%	1,355
營業淨利	1,621	2,321	43%	444
稅前淨利	1,693	2,602	54%	520
合併淨利	1,088	1,744	60%	402
歸屬母公司純益	856	1,595	86%	339
來自精成科貢獻	168	230	37%	76
來自博德貢獻	688	1,365	98%	263
每股盈餘(元)	1.90	3.55	87%	0.75
毛利率(%)	13.5%	14.9%	1.4%	14.3%
營業利益率(%)	4.1%	5.3%	1.2%	4.7%
淨利率(%)	2.7%	4.0%	1.3%	4.2%

合併營收與各項比率趨勢(各季)



第1季同期營收與各項比率趨勢

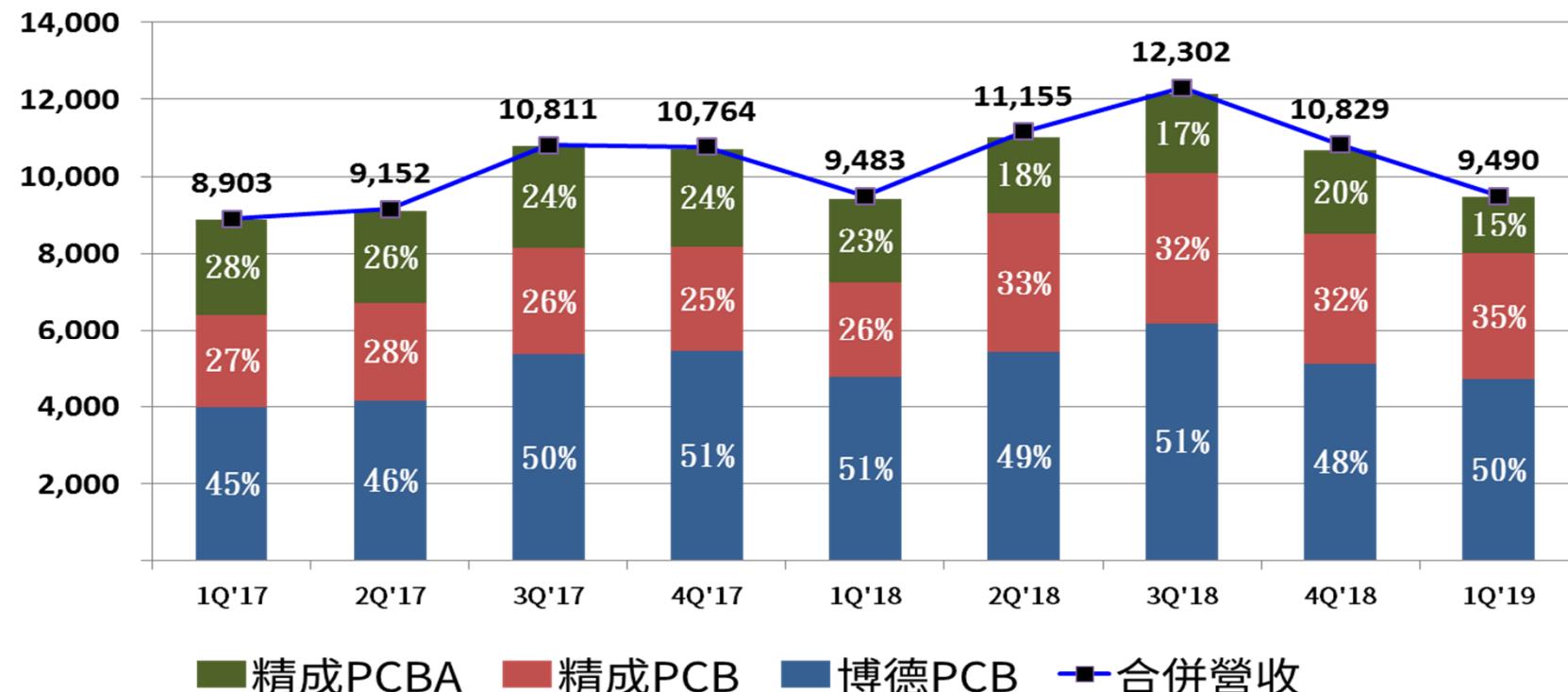


合併資產負債表

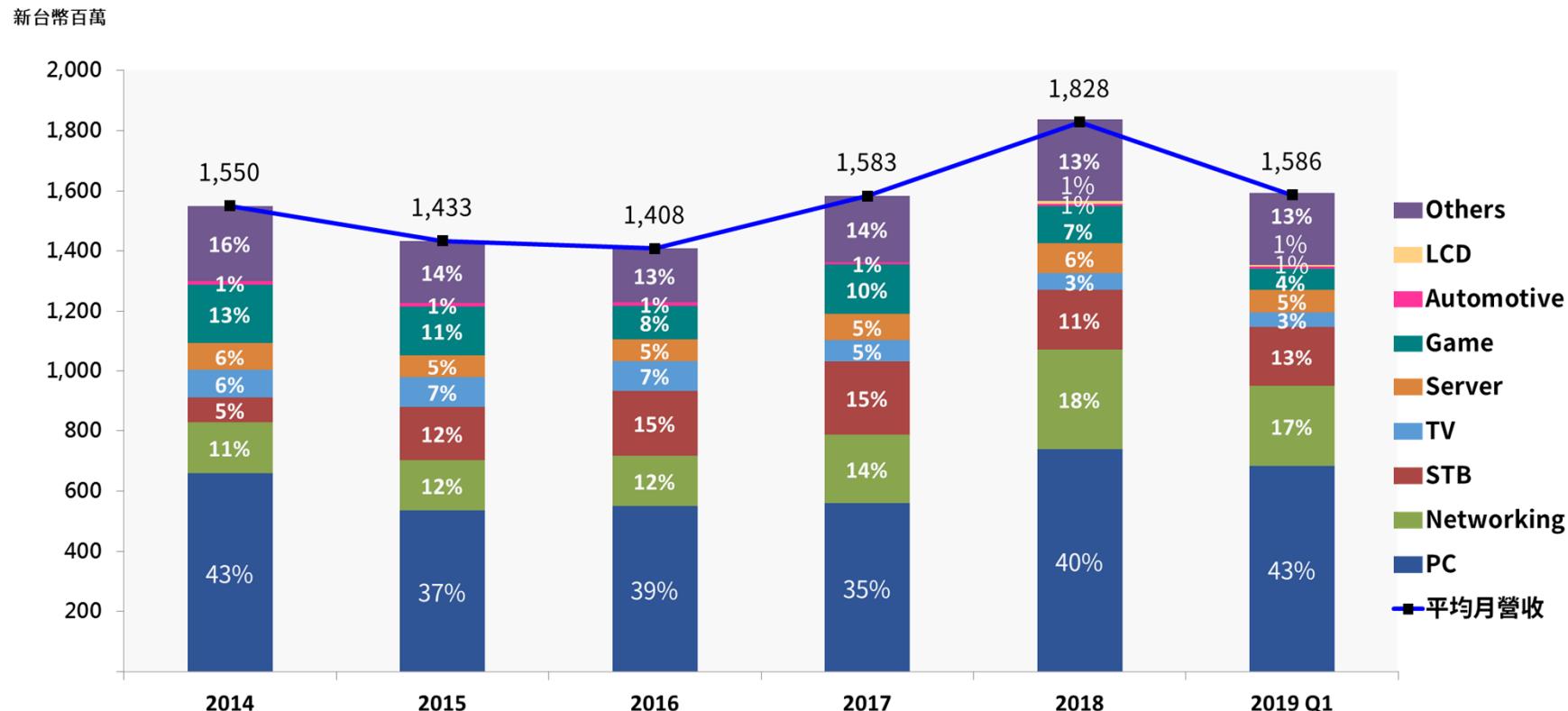
新台幣：百萬	Dec.31 '17	%	Dec.31 '18	%	Mar.31 '19	%
流動資產	35,004	61%	34,821	56%	32,908	52%
非流動資產	22,391	39%	27,369	44%	30,795	48%
資產總計	57,395	100%	62,190	100%	63,703	100%
流動負債	23,039	40%	22,575	36%	19,728	31%
非流動負債	10,827	19%	12,016	19%	12,663	20%
負債總計	33,866	59%	34,591	56%	32,391	51%
本公司業主權益	15,618	27%	18,733	30%	21,438	34%
非控制權益	7,911	14%	8,866	14%	9,874	16%
權益總計	23,529	41%	27,599	44%	31,312	49%
負債與權益總計	57,395	100%	62,190	100%	63,703	100%
每股淨值(元)	34.67		41.59		47.59	

合併營收趨勢(瀚宇博德+精成科)

新台幣:百萬

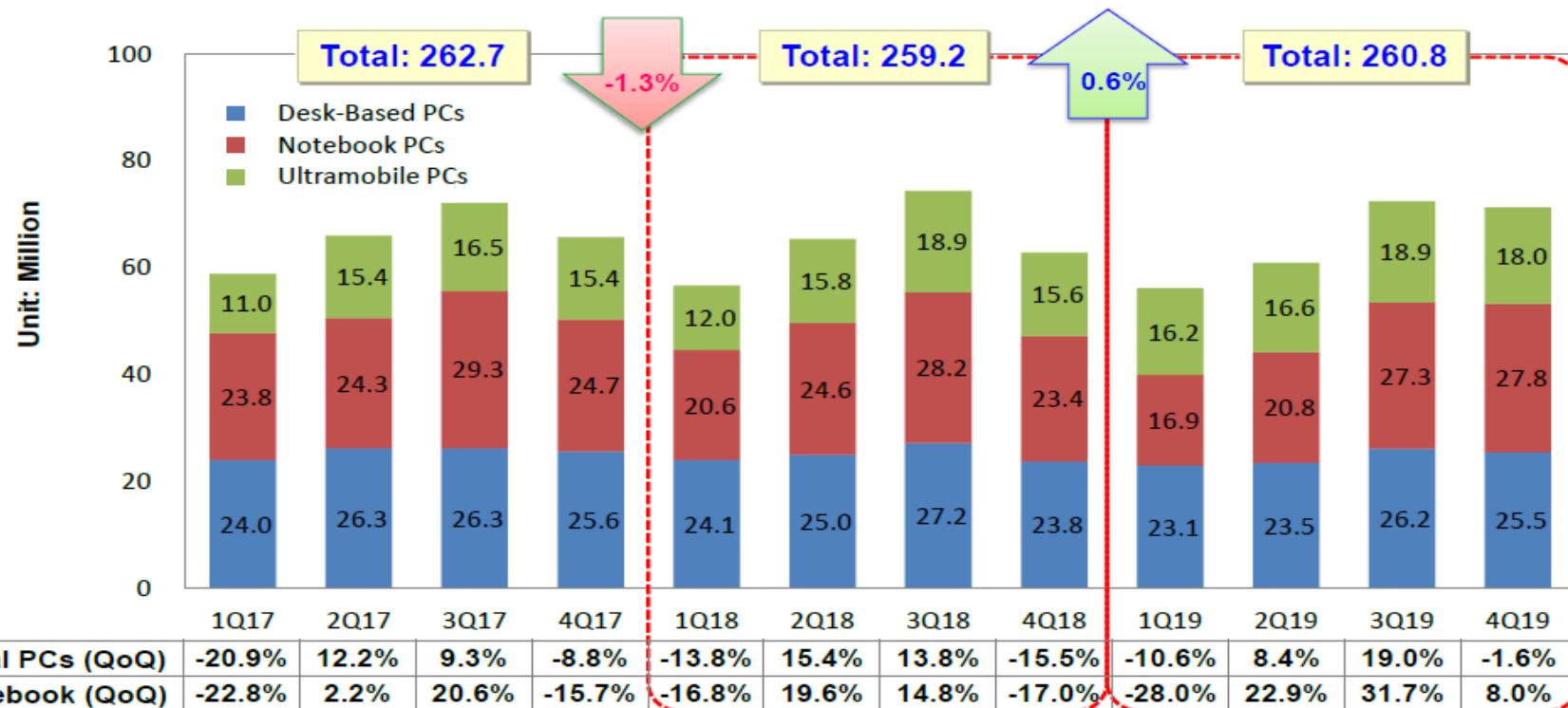


近年產品組合趨勢(瀚宇博德 Only)



營運與展望

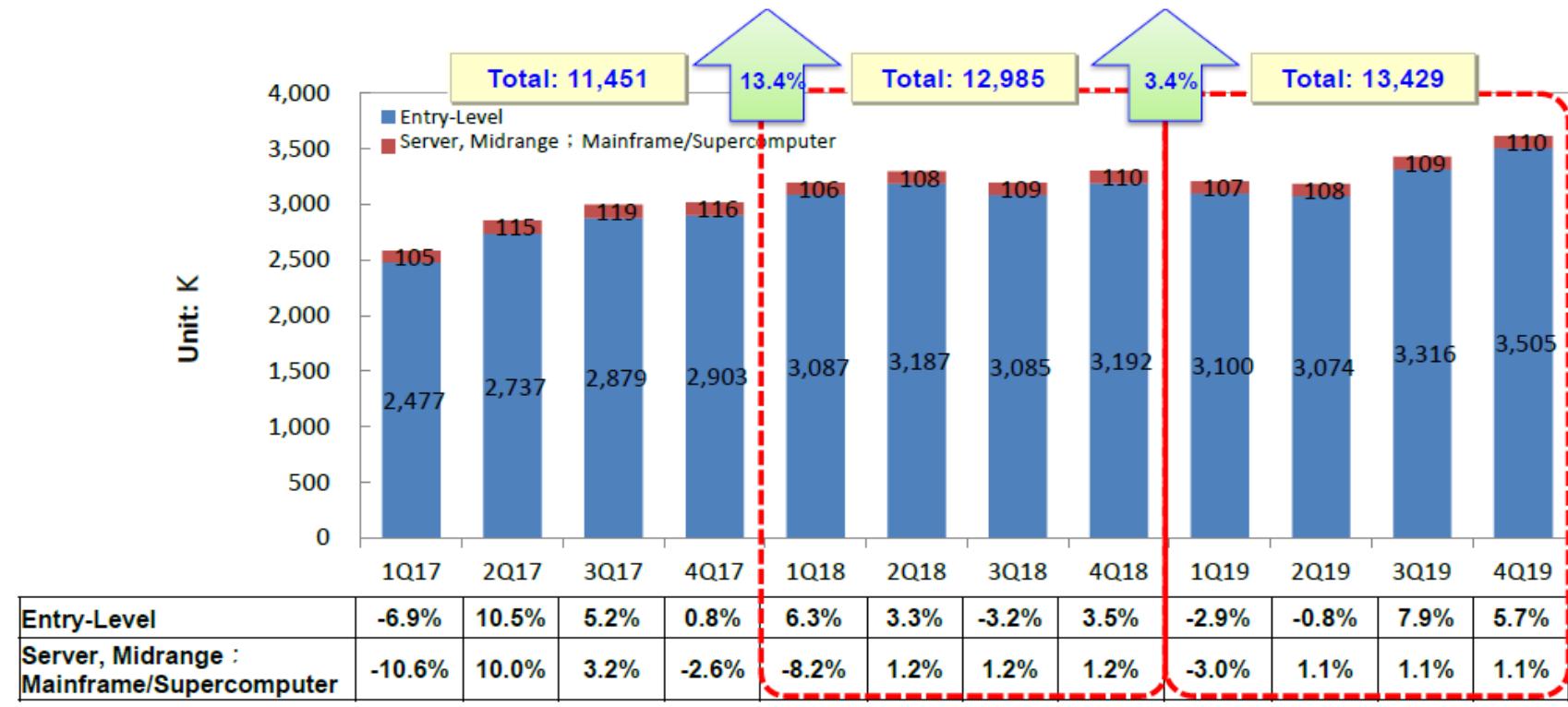
2019年PC需求預測



資料來源：工研院產科國際所(2019/02)、台灣電路版協會。

Copyright © by Passive System Alliance | All rights reserved.

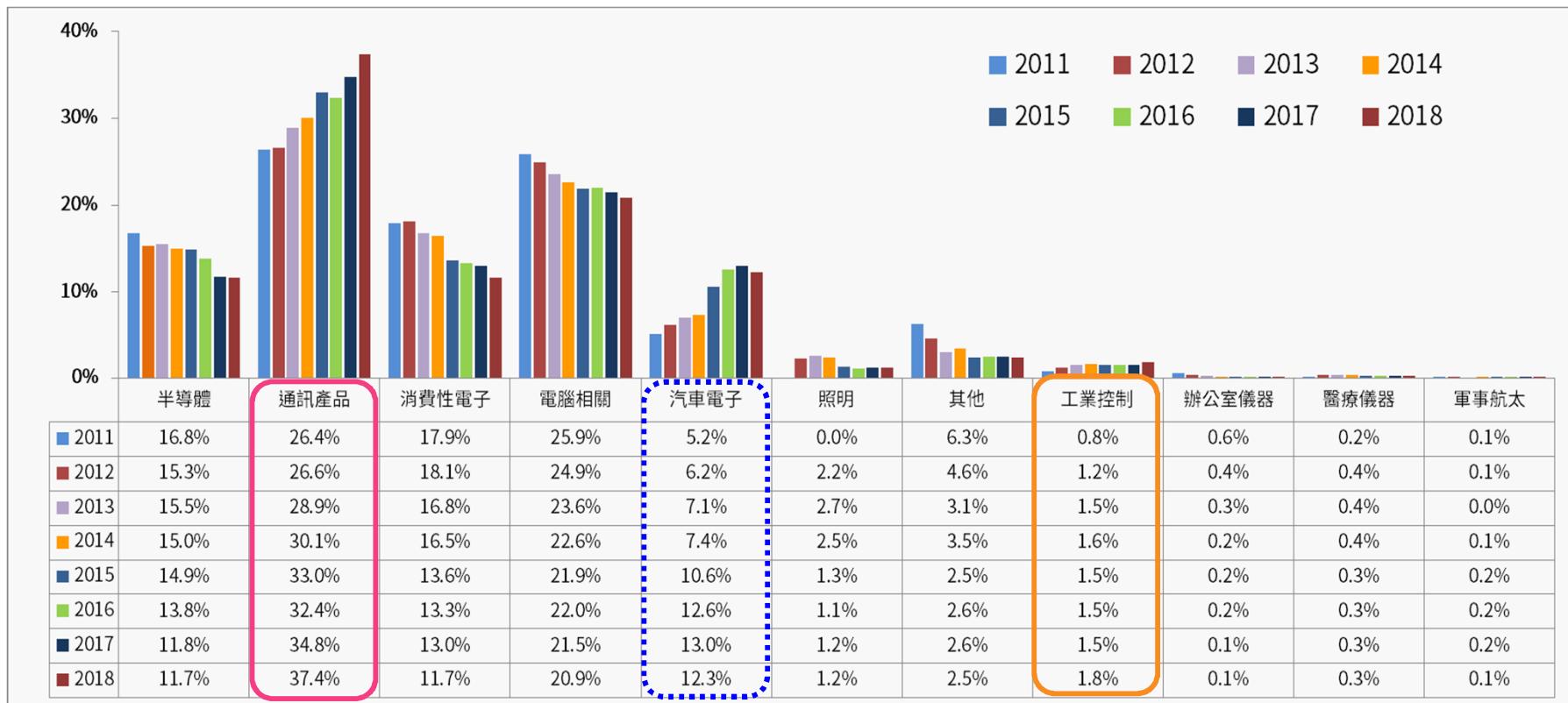
2019年伺服器需求預測



資料來源：工研院產科國際所(2019/02)、台灣電路版協會。

Copyright © by Passive System Alliance | All rights reserved.

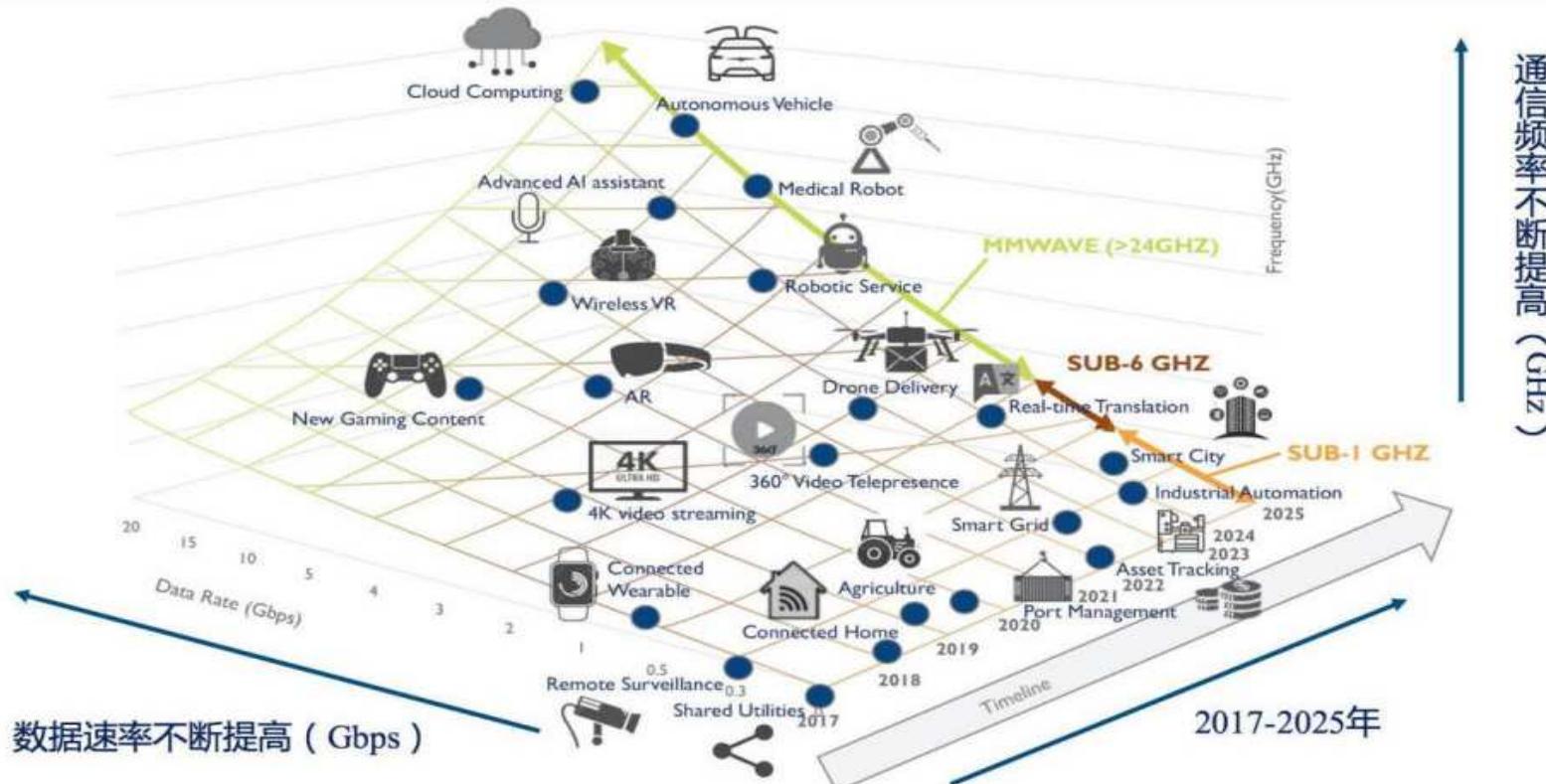
通訊產品扮演主要PCB產業成長動能



資料來源：工研院產科國際所(2019/02)、台灣電路版協會。

Copyright © by Passive System Alliance | All rights reserved.

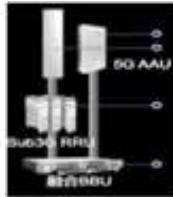
5G 應用主要技術規格時程



資料來源：Yole Développement, 中信建投證券.

Copyright © by Passive System Alliance | All rights reserved.

5G通訊衍生之電路板相關需求

	基礎建設	行動終端	用戶終端設備	5G應用	
應用載具	戶外大型基地台 	小型基地台 (small cell) 	智能型手機 	路由器、交換機… 	各式連網設備 
關鍵模塊	無線、功率放大器、通訊櫃背板	高速多層板、高頻微波板	上下天線、RF相關	天線、通訊高速多層板	連網模塊
相關需求	大尺寸、多層、高頻/高速	高頻/高速、材料混壓	軟性天線、AiP(Antenna in Package)	高頻/高速、材料混壓	大尺寸、多層、高頻/高速、金屬基板
潛在市場	大	大	較大	中	較大
市場起點	2018~較近	2019~近	2020~遠	2020~遠	2021~較遠

資料來源：工研院產科國際所、台灣電路版協會。

Copyright © by Passive System Alliance | All rights reserved.

營運重點

- 掌握前端市場,積極參與5G相關產品開發進程, 加強對終端客戶服務, 全力配合客戶認證及指定.
- 產品組合不僅聚焦現階段量大產品,並增加利基型及少量多樣產品.
- 持續進行自動化設備及製程能力管控.
- 各廠產品走向專精化,提升生產效率及良率.

Thank you!

本資料均屬機密，僅供指定之收件人使用，未經寄件人許可不得揭露、複製或散佈本信件。

This message and any attachments are confidential and may be legally privileged. Any unauthorized review, use or distribution by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please immediately notify the sender, completely delete this documents, and destroy all copies. Your cooperation will be highly appreciated.

